2026 年 11 月 25 日

各　位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長　山崎　秀和
所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

「HKPCA SHOW 2026」への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 12 月 2 日（水）～4 日（金）に深セン国際会展中心で開催される「HKPCA SHOW 2026」（国際電子回路（深セン）展覧会）に出展いたします。



本展覧会は、香港プリント回路協会が主催する、PCB および電子実装業界の最前線を牽引する世界最大規模の展示会です。今回は「AI が駆動するテクノロジー」をテーマに、PCB の全生産プロセスにおける AI を活用したスマート製造ソリューションを集中的に展示し、産業のインテリジェント化への移行を支援します。

当社ブースでは、以下の製品モデルを展示し、製品品質の向上に貢献するソリューションをご紹介します。

〈展示内容〉

■「RSH-S80iFAMP」

2D および 3D レーザーを用いて、FCCSP などの基板におけるバンプの欠陥や厚さのばらつきを一度のスキャンで高精度に測定・判定できる検査装置

■「NATS®-2120」

パワーチップ内蔵基板の静的電気特性の検査をメインとし、LCR パラメータや回路の短絡・断線などの電気的異常を検出できる電気検査装置

■「SREC® M6VSW+AGV」

大型 HDI や多層基板などに対して、画像認識を用いた高精度な位置合わせと四端子検査により、電気的な導通や異常を自動で検査できる装置

■「NX-AISIS™ X-Ray Automatic Inspection (AXI)」

プリント基板やパッケージ基板に X 線を照射して内部構造をデジタル画像化し、非破壊で基板内部の欠陥を検査できる自動 X 線検査装置

〈出展概要〉

・会期：2026 年 12 月 2 日（水）～12 月 4 日（金）
・会場：深セン国際会展中心(宝安館)
・ブース：7A21
・公式サイト：https://www.hkpcashow.org/